



日 本 国 特 許 庁

PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日

Date of Application:

2000年 5月12日

出 願 番 号

Application Number:

特願2000-141022

出 願 人

Applicant (s):

花王株式会社

2001年 4月13日

Commissioner,
Patent Office

及 川 耕 造

【書類名】 特許願

【整理番号】 KAP00-0310

【提出日】 平成12年 5月12日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 C09K 3/14

【発明者】

 【住所又は居所】 和歌山市湊 1 3 3 4 番地 花王株式会社研究所内

 【氏名】 藤井 滋夫

【発明者】

 【住所又は居所】 和歌山市湊 1 3 3 4 番地 花王株式会社研究所内

 【氏名】 大島 良暁

【特許出願人】

 【識別番号】 000000918

 【氏名又は名称】 花王株式会社

【代理人】

 【識別番号】 100095832

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 細田 芳徳

【手数料の表示】

 【予納台帳番号】 050739

 【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

 【物件名】 明細書 1

 【物件名】 図面 1

 【物件名】 要約書 1

【提出書類の枚数】 2

【書類名】 明細書

【発明の名称】 研磨液組成物

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 水、研磨材、ロールオフ低減剤および中間アルミナを含有してなる研磨液であって、ロールオフ低減剤が O H 基又は S H 基を有する炭素数 2 ～ 2 0 のカルボン酸、炭素数 1 ～ 2 0 のモノカルボン酸、炭素数 2 ～ 3 のジカルボン酸及びこれらの塩からなる群より選ばれる 1 種以上である研磨液組成物。

【請求項 2】 請求項 1 記載の研磨液組成物を用いて被研磨基板を研磨する被研磨基板の研磨方法。

【請求項 3】 請求項 1 記載の研磨液組成物を用いて、被研磨基板を研磨する工程を有する基板の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

【発明の属する技術分野】

本発明は、研磨液組成物に関する。さらに、該研磨液組成物を用いた被研磨基板の研磨方法及び該研磨液組成物を用いた基板の製造方法に関する。

【0 0 0 2】

【従来技術】

ハードディスクは、年々小型化、高容量化の一途をたどり、その高密度化が進み、最小記録面積が小さくなり、また磁気ヘッドの浮上量もますます小さくなっていることから、ハードディスク基板の研磨工程で、研磨速度の向上及び表面粗さの低減及びスクラッチ、ピット、等の表面欠陥の低減が求められ、水、アルミナ及びペーマイトとキレート性化合物とを用いた研磨液組成物（特開平 11-9 2749 号公報等）や水、 α アルミナ、および酢酸で安定化したアルミナゾルを含有した研磨液組成物（特開 2000-63805 号公報）や研磨方法が検討されている。

一方、高容量化においては、研磨工程で発生するロールオフ（基板の端面汚れ）を小さくし、より外周部まで記録できる基板を開発するため、研磨パッドを堅くする、研磨加重を小さくするなどの機械的研磨条件が検討されている。

【0 0 0 4】

しかしながら、このロールオフを小さくするためのそれら機械的研磨条件は効果があるものの今だ充分とは言えず、またロールオフを低減し得る研磨液の組成の検討もなされていないのが現状である。

【0 0 0 5】

【発明が解決しようとする課題】

本発明の目的は、研磨速度が向上し、被研磨物の表面に表面欠陥を生じさせることなく、表面粗さを低減し、且つロールオフを低減し得る研磨液組成物、該研磨液組成物を用いた被研磨基板の研磨方法及び基板の製造方法を提供することにある。

【0 0 0 6】

【課題を解決するための手段】

即ち、本発明の要旨は、

〔1〕 水、研磨材、ロールオフ低減剤および中間アルミナを含有してなる研磨液であって、ロールオフ低減剤がOH基又はSH基を有する炭素数2～20のカルボン酸、炭素数1～20のモノカルボン酸、炭素数2～3のジカルボン酸及びこれらの塩からなる群より選ばれる1種以上である研磨液組成物、

〔2〕 前記〔1〕記載の研磨液組成物を用いて被研磨基板を研磨する被研磨基板の研磨方法、

〔3〕 前記〔1〕記載の研磨液組成物を用いて、被研磨基板を研磨する基板の製造方法、に関する。

【0 0 0 7】

【発明の実施の形態】

本発明の研磨液組成物は、水、研磨材、ロールオフ低減剤および中間アルミナを含有している研磨液であって、ロールオフ低減剤が、OH基又はSH基を有する炭素数2～20のカルボン酸、炭素数1～20のモノカルボン酸、炭素数2～3のジカルボン酸及びこれらの塩からなる群より選ばれる1種以上である。

【0 0 0 8】

本発明で用いられる研磨材は、研磨剤として一般に使用される研磨材を使用す

ることができる。該研磨材の例としては、金属；金属又は半金属の炭化物、窒化物、酸化物、ホウ化物；ダイヤモンド等が挙げられる。金属又は半金属元素は、周期律表（長周期型）の 2 A、2 B、3 A、3 B、4 A、4 B、5 A、6 A、7 A 又は 8 族由来のものである。研磨材の具体例として、 α -アルミナ粒子、炭化ケイ素粒子、ダイヤモンド粒子、酸化マグネシウム粒子、酸化亜鉛粒子、酸化セリウム粒子、酸化ジルコニウム粒子、コロイダルシリカ粒子、ヒュームドシリカ粒子等が挙げられ、これらを 1 種以上使用することは、研磨速度を向上させる観点から好ましい。中でも、 α -アルミナ粒子、酸化セリウム粒子、酸化ジルコニウム粒子、コロイダルシリカ粒子、ヒュームドシリカ粒子等がさらに好ましく、 α -アルミナ粒子が特に好ましい。

【0009】

研磨材の一次粒子の平均粒径は、研磨速度を向上させる観点から、好ましくは $0.01 \sim 3 \mu\text{m}$ 、さらに好ましくは $0.02 \sim 0.8 \mu\text{m}$ 、特に好ましくは $0.05 \sim 0.5 \mu\text{m}$ である。さらに、一次粒子が凝集して二次粒子を形成している場合は、同様に研磨速度を向上させる観点及び被研磨物の表面粗さを低減させる観点から、その二次粒子の平均粒径は、好ましくは $0.05 \sim 3 \mu\text{m}$ 、さらに好ましくは $0.1 \sim 1.5 \mu\text{m}$ 、特に好ましくは $0.2 \sim 1.2 \mu\text{m}$ である。研磨材の一次粒子の平均粒径は、走査型電子顕微鏡で観察（好適には 3000～30000 倍）して画像解析を行い、粒径を測定することにより数平均粒径として求めることができる。また、二次粒子の平均粒径はレーザー光回折法を用いて体積平均粒径として測定することができる。

【0010】

研磨材の比重は、分散性及び研磨装置への供給性や回収再利用性の観点から、その比重は 2～6 であることが好ましく、2～5 であることがより好ましい。

【0011】

さらに、別の観点から、研磨液組成物中において好ましくは 1～10 重量%、より好ましくは 2～30 重量%、さらに好ましくは 3～15 重量%である。

【0012】

—

ン酸、デカン酸、ラウリン酸等が挙げられる。これらの中で、酢酸、シュウ酸、マロン酸、グリコール酸、乳酸、リンゴ酸、酒石酸、グリオキシル酸、クエン酸及びグルコン酸が好ましく、さらに好ましくは、シュウ酸、マロン酸、グリコール酸、乳酸、リンゴ酸、酒石酸、グリオキシル酸、クエン酸及びグルコン酸である。なお、本発明に用いられるモノカルボン酸及びジカルボン酸は、OH基又はSH基を有しないカルボン酸から選ばれる。

【0017】

また、これらの酸の塩としては、特に限定はなく、具体的には、金属、アンモニウム、アルキルアンモニウム、有機アミン等との塩が挙げられる。金属の具体例としては、周期律表（長周期型）1A、1B、2A、2B、3A、3B、4A、6A、7A又は8族に属する金属が挙げられる。これらの金属の中でも、ロールオフ低減の観点から1A、3A、3B、7A又は8族に属する金属が好ましく、1A、3A又は3B族に属する金属が更に好ましく、1A族に属するナトリウム、カリウムが最も好ましい。

【0018】

アルキルアンモニウムの具体例としては、テトラメチルアンモニウム、テトラエチルアンモニウム、テトラブチルアンモニウム等が挙げられる。

【0019】

有機アミン等の具体例としては、ジメチルアミン、トリメチルアミン、アルカノールアミン等が挙げられる。

【0020】

これらの塩の中では、アンモニウム塩、ナトリウム塩及びカリウム塩が特に好ましい。

【0021】

ロールオフ低減剤の含有量は、ロールオフを低減する観点及び経済的な観点から、0.01重量%以上、0.1重量%以下であることが好ましい。さらに好ましくは、0.05重量%以上、0.05重量%以下である。なお、ロールオフ低減剤は、単独で又は2種以上を混合して用いることができる。

【0022】

また、本発明に用いられる中間アルミナとは、 α -アルミナ粒子以外のアルミナ粒子の総称であり、具体的には、 γ -アルミナ粒子、 δ -アルミナ粒子、 θ -アルミナ粒子、 η -アルミナ粒子、 κ -アルミナ粒子、これらの混合物等が挙げられる。その中でも、研磨速度向上及び表面粗さ低減効果の観点から、以下の中間アルミナが好ましい。その結晶型は、好ましくは γ -アルミナ、 δ -アルミナ、 θ -アルミナ及びその混合物である。また、その比表面積（BET法）は、好ましくは $30 \sim 300 \text{ m}^2 / \text{g}$ 、より好ましくは $50 \sim 200 \text{ m}^2 / \text{g}$ である。その平均粒径は、好ましくは $0.01 \sim 5 \text{ } \mu\text{m}$ 、より好ましくは $0.05 \sim 5 \text{ } \mu\text{m}$ 、さらに好ましくは $0.1 \sim 3 \text{ } \mu\text{m}$ 、特に好ましくは $0.1 \sim 1.5 \text{ } \mu\text{m}$ である。この平均粒径は、レーザー光回折法（例えば、堀場製LA-920）を用いて体積平均粒径として測定することができる。また、中間アルミナ粒子におけるアルカリ金属及びアルカリ土類金属の含有量は、それぞれ0.1重量%以下が好ましく、0.05重量%以下がより好ましく、0.01重量%以下が特に好ましい。

【0023】

例えば、比表面積が比較的大きく、アルカリ金属及びアルカリ土類金属含有量の少ない水酸化アルミニウム、アルミナゾル等を原料とした場合、製造された中間アルミナの融着が少なく粒子強度も小さいため、被研磨基板の表面欠陥が無く、表面粗さ低減に特に有効である。

【0024】

そのための原料としては、化学式 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 、 $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 、 AlOOH 、 $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 、 $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ 〔 n は1～3を示す〕で表わされる、例えば、水酸化アルミニウム、アルミナゾル等が使用できるが、その原料の比表面積が好ましくは $10 \text{ m}^2 / \text{g}$ 以上、より好ましくは $30 \text{ m}^2 / \text{g}$ 以上、特に好ましくは $50 \text{ m}^2 / \text{g}$ 以上のものである。また、アルカリ金属及びアルカリ土類金属の含有量が好ましくは0.1重量%以下、より好ましくは0.

、水酸化アルミニウムを加熱脱水して中間アルミナを製造する場合に、焼成時に強制的に乾燥空気あるいは窒素ガスを導入させることは、さらに被研磨基板の表面欠陥、表面粗さ低減に有効である。尚、前記加熱脱水処理は、常法により行

•

1

開平3-115383号公報2 頁右下欄16行～3 頁左上欄11行、特開平4-108887号公報2 頁左下欄1 行～9 行、特開平4-275387号公報2 頁右欄27行～3 頁左欄12行、特開平4-363385号公報2 頁右欄21行～30行等に記載されているものが挙げられる。

【0 0 3 1】

これらの成分は単独で用いても良いし、2 種以上を混合して用いても良い。また、その含有量は、それぞれの機能を発現させる観点及び経済性の観点から、好ましくはロールオフ低減剤組成物中0. 0 5～2 0 重量%、より好ましくは0. 0 5～1 0 重量%、さらに好ましくは0. 0 5～5 重量%である。

【0 0 3 2】

尚、前記研磨液組成物中の各成分の濃度は、研磨する際の好ましい濃度であるが、該組成物製造時の濃度であってもよい。通常、濃縮液として組成物は製造され、これを使用時に希釈して用いる場合が多い。

【0 0 3 3】

研磨液組成物のp Hは、被研磨物の種類や要求品質等に応じて適宜決定することが好ましい。例えば、研磨液組成物のp Hは、基板の洗浄性及び加工機械の腐食防止性、作業者の安全性の観点から、2 ～1 2 が好ましい。また、被研磨物がNi-Pメッキされたアルミニウム合金基板等の金属を主対象とした精密部品用基板である場合、研磨速度の向上と表面品質の向上の観点から、2 ～9 がより好ましく、3 ～8 が特に好ましい。さらに、半導体ウェハや半導体素子等の研磨、特にシリコン基板、ポリシリコン膜、S i O₂ 膜等の研磨に用いる場合は、研磨速度の向上と表面品質の向上の観点から、7 ～1 2 が好ましく、8 ～1 2 がより好ましく、9 ～1 1 が特に好ましい。該p Hは、必要により、硝酸、硫酸等の無機酸、有機酸、アンモニア、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム等の塩基性物質を適宜、所望量で配合することで調整することができる。

【0 0 3 4】

本発明の研磨液組成物は組成となるように各成分を混合して研磨液を調製して被研磨基板を研磨する工程を有しており、特に精密部品用基板を好適に製造することができる。

【 0 0 3 5 】

本発明の対象である被研磨基板に代表される被研磨物の材質は、例えば、シリコン、アルミニウム、ニッケル、タングステン、銅、タンタル、チタン等の金属又は半金属、及びこれらの金属を主成分とした合金、ガラス、ガラス状カーボン、アモルファスカーボン等のガラス状物質、アルミナ、二酸化ケイ素、窒化ケイ素、窒化タンタル、窒化チタン等のセラミック材料、ポリイミド樹脂等の樹脂等が挙げられる。これらの中では、アルミニウム、ニッケル、タングステン、銅等の金属及びこれらの金属を主成分とする合金が被研磨物であるか、又はそれらの金属を含んだ半導体素子等の半導体基板が被研磨物であることが好ましい。特にNi-Pメッキされたアルミニウム合金からなる基板を研磨する際に、本発明の研磨液組成物を用いた場合、ロールオフが小さく、研磨速度を向上させ、表面欠陥を生じさせることなく、表面粗さを低減させることができるので好ましい。

【 0 0 3 6 】

これらの被研磨物の形状には、特に制限は無く、例えばディスク状、プレート状、スラブ状、プリズム状等の平面部を有する形状や、レンズ等の曲面部を有する形状が本発明の研磨液組成物を用いた研磨の対象となる。その中でも、ディスク状の被研磨物の研磨に特に優れている。

【 0 0 3 7 】

本発明の研磨液組成物は、精密部品用基板の研磨に好適に用いられる。例えば、磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク等の磁気記録媒体の基板、フォトマスク基板、光学レンズ、光学ミラー、光学プリズム、半導体基板等の研磨に適している。半導体基板の研磨は、シリコンウェハ（ベアウェハ）のポリッシング工程、埋め込み素子分離膜の形成工程、層間絶縁膜の平坦化工程、埋め込み金属配線の形成工程、埋め込みキャパシタ形成工程等において行われる研磨がある。本発明の研磨液組成物は、特に磁気ディスク基板の研磨に適している。磁気ディスクの研磨は、例えば、磁気ディスクの表面を研磨液組成物を用いて研磨することによって行われる。本発明の研磨液組成物は、特に磁気ディスクの研磨に適している。

【 0 0 3 8 】

また、本発明の研磨液組成物を用いた基板の製造方法は、例えば、例えば、本発明の研磨液組成物を用いて基板を研磨することによって行われる。

布状の有機高分子系の研磨布等を貼り付けた研磨盤で上記被研磨基板を挟み込み、本発明の研磨液組成物を研磨面に供給し、一定の圧力を加えながら研磨盤や基板を動かすことにより、ロールオフや表面粗さが低減し、表面欠陥のない基板を製造する方法が挙げられる。

【 0 0 3 9 】

本発明において被研磨基板に発生したロールオフは、例えば、触針式または光学式形状測定装置を用いて端面部分の形状を測定し、そのプロファイルより端面部分がディスク中央部に比べてどれくらい多く削れているかを数値化することにより評価することができる。

【 0 0 4 0 】

数値化の方法は、図 1 に示すように、ディスク中心からある距離離れた A 点と B 点と C 点といった測定曲線（被研磨基板の端面部分の形状を意味する）上の 3 点を取り、A 点と C 点を結んだ直線をベースラインとし、B 点とベースラインとの距離（D）をいうものである。ロールオフが良いとは、D の値がより 0 に近いことを言う。ロールオフ値は、D を研磨前後のディスクの厚さの変化量の $1/2$ で除した値を言う。ロールオフ値は好ましくは $0.2 \mu\text{m}/\mu\text{m}$ 以下、より好ましくは $0.15 \mu\text{m}/\mu\text{m}$ 、さらに好ましくは $0.10 \mu\text{m}/\mu\text{m}$ である。

【 0 0 4 1 】

なお、A 点、B 点及び C 点の位置は、被測定物の大きさにより様々であるが、一般に B 点はディスクの端部と中心を結ぶ線上をディスクの端部から 0.5 mm の位置、C 点は 2.5 mm の位置、A 点は 4.5 mm の位置であることが好ましい。例えば、 3.5 インチディスクの場合は、A 点、B 点及び C 点をそれぞれディスク中心から 43 mm 、 47 mm 及び 45 mm の距離にとることが好ましい。

【 0 0 4 2 】

以上のように、本発明の研磨液組成物を用いることで、表面に表面欠陥を生じず、表面粗さを低減した高品質の基板を生産効率良く製造することができる。

【 0 0 4 3 】

本発明の研磨液組成物は、表面粗さを低減し、表面欠陥を低減する効果があるが、以下

以外の研磨工程、例えば、ラッピング工程等にも同様に適用することができる。

【0044】

【実施例】

＜中間アルミナ製造例1＞

平均粒径 $25\mu\text{m}$ 、比表面積 $250\text{m}^2/\text{g}$ 、アルカリ金属含量 0.003 重量%、アルカリ土類金属含量 0.01 重量%の擬ベーマイト粒子 100g をアルミナ容器（縦 $200\times$ 横 $100\times$ 高さ 100mm ）に入れ、マッフル炉で昇温速度 $50^\circ\text{C}/\text{min}$ 、焼成温度 930°C 、4時間、窒素流量 $5\text{L}/\text{min}$ にて焼成して、中間アルミナを得た。これを 2L アルミナ製ボールミルに移し、イオン交換水を加え 30 重量%スラリーとした後、 $3\text{mm}\phi$ のアルミナボールを入れ、解砕して、中間アルミナ粒子を調製した。調製した中間アルミナ粒子は、X線回折ピークの解析により γ -アルミナであり、平均粒径 $0.3\mu\text{m}$ 、比表面積 $150\text{m}^2/\text{g}$ 、アルカリ金属含量 0.005 重量%、アルカリ土類金属含量 0.01 重量%であった。

【0045】

実施例1～5及び比較例1～5

研磨材（一次粒子の平均粒径 $0.25\mu\text{m}$ 、二次粒子の平均粒径 $0.8\mu\text{m}$ の α -アルミナ（純度約 99.9% ））、ロールオフ低減剤、製造例1で得られた中間アルミナ（ γ -アルミナ）及び残部イオン交換水とを表1に示す組成となるようにし、実施例1～5、比較例2、3、5はアンモニア水で、また、比較例1、4は硝酸で pH を 4.0 に調整し、混合・攪拌して研磨液組成物 100 重量部を調製した。

【0046】

【表 1】

	α -7ルミナ (重量部)	ロータ 低減剤	添加量 (重量部)	中間7ルミナ または 7ルミナゾル ¹⁾	添加量 (重量部)
実施例 1	7	グリコール 酸	0. 1 5	中間7ルミナ	1
実施例 2	7	リンゴ酸	0. 1 5	中間7ルミナ	1
実施例 3	7	酒石酸	0. 1 5	中間7ルミナ	1
実施例 4	7	マロン酸	0. 1 5	中間7ルミナ	1
実施例 5	7	クエン酸	0. 1 5	中間7ルミナ	1
比較例 1	7	無し	—	無し	—
比較例 2	7	エチレンジアミンテトラ 酢酸 27ンモニウム	0. 1 5	中間7ルミナ	1
比較例 3	7	コハク酸	0. 1 5	7ルミナゾル	1
比較例 4	7	グルコン酸	0. 1 5	7ルミナゾル	1
比較例 5	7	グリコール 酸	0. 1 5	7ルミナゾル	1

1) 日産化学(株)製 アルミナゾルー 2 0 0

【0 0 4 7】

得られた研磨液組成物を用い、下記の方法によって測定した中心線平均粗さRaが $0.2\ \mu\text{m}$ 、厚さ $0.8\ \text{mm}$ 、直径 $3.5\ \text{インチ}$ のNi-Pメッキされたアルミニウム合金基板の表面を両面加工機により、以下の両面加工機の設定条件でポリッシングし、磁気記録媒体用基板として用いられるNi-Pメッキされたアルミニウム合金基板の研磨物を得た。

【0 0 4 8】

両面加工機の設定条件を下記に示す。

使用両面加工機：スピードファム社製 9 B 型両面加工機

加工圧力： $9.8\ \text{kPa}$

研磨パッド：ポリテックスDG-H（ロデールニッタ社製）

定盤回転数： 55r/min

研磨液組成物供給流量： 100mL/min

研磨時間：1 min

【0 0 4 9】

研磨後、アルミニウム合金基板の厚さを膜厚計（ミットヨ（株）製、レーザー膜厚計 Model 1000）を用いて測定し、測定値を研磨前後の厚さの差で割ることで

基板の厚さの変化から厚さの減少速度を求め、比較例 1 を基準として相対値（相対速度）を求めた。

【 0 0 5 0 】

また、研磨後の各基板の表面粗さ（中心線平均粗さ Ra）、ピット及びロールオフを以下の方法に従って測定した。なお、中心線平均粗さ Ra は比較例 1 を基準として相対値（相対粗さ）を求めた。また、ロールオフは比較例 2 のロールオフ値を基準として相対値（相対ロールオフ）を求めた。これらの結果を表 2 に示す。

【 0 0 5 1 】

[中心線平均粗さ Ra]

ランク・テラーホブソン社製のタリーステップを用いて以下の条件で測定した。

触針先端サイズ : 25 μm \times 25 μm

ハイパスフィルター : 80 μm

測定長さ : 0.64 mm

【 0 0 5 2 】

[表面欠陥（ピット）]

光学顕微鏡観察（微分干渉顕微鏡）を用いて倍率 $\times 200$ 倍で各基板の表面を 30 度おきに 12 カ所観察し、ピットの数数を数えた。

S : 0 個

A : 1 ~ 3 個

B : 4 ~ 10 個

C : 10 個以上

【 0 0 5 3 】

[ロールオフ]

測定装置 : ミットヨ フォームトレーサー SV-C 6 2 4

触針 : 1 μm 径の球形

速度 : 0.2 mm / s

解析ソフト : SV-C 4 敬和輪郭解析システム (敬和工業株式会社製)

フィルター：LPF (Gaussian) 0.800mm

【0054】

上記の装置を用いて、ディスク中心から42.5mmから47.5mmまでのディスク端部の形状を測定し、A、B及びC点の位置をディスク中心からそれぞれ43mm、47mm及び45mmにとり、解析ソフトを用いて前記測定方法により、Dを求めた。この求められたDを研磨前後のディスクの厚さの変化量の1/2で除した値をロールオフ値とした。

【0055】

【表2】

	特性評価			
	研磨速度 (-)	表面粗さ (-)	表面欠陥 (欠)	ロールオフ (-)
実施例1	1.6	0.68	S	0.21
実施例2	1.7	0.65	S	0.23
実施例3	1.6	0.70	S	0.24
実施例4	1.4	0.65	S	0.25
実施例5	1.7	0.72	S	0.25
比較例1	1	1	C	測定不可能*1
比較例2	1.6	0.70	S	1*2
比較例3	1.5	1.2	A	0.83
比較例4	1.4	1.1	A	0.40
比較例5	1.1	1.1	A	0.25

*1：スキージャンプ発生により測定できなかった。

*2：ロールオフ値0.36 $\mu\text{m}/\mu\text{m}$ であった。

【0056】

表2の結果より、実施例1～5で得られた研磨液組成物は、いずれも研磨速度が高く、特に比較例1～5で得られた研磨液組成物に比べ、被研磨基板の表面粗さを低減し、表面欠陥がなく、且つロールオフも著しく低減しうるものである。

【0057】

【発明の効果】

本発明の研磨液組成物を被研磨基板上に研磨し、特に、比較例1～5と比較し、

のロールオフや表面粗さを著しく低減させることに加え、表面欠陥が無く、且つ
研磨速度も向上させることができるという効果が奏される。

【図面の簡単な説明】

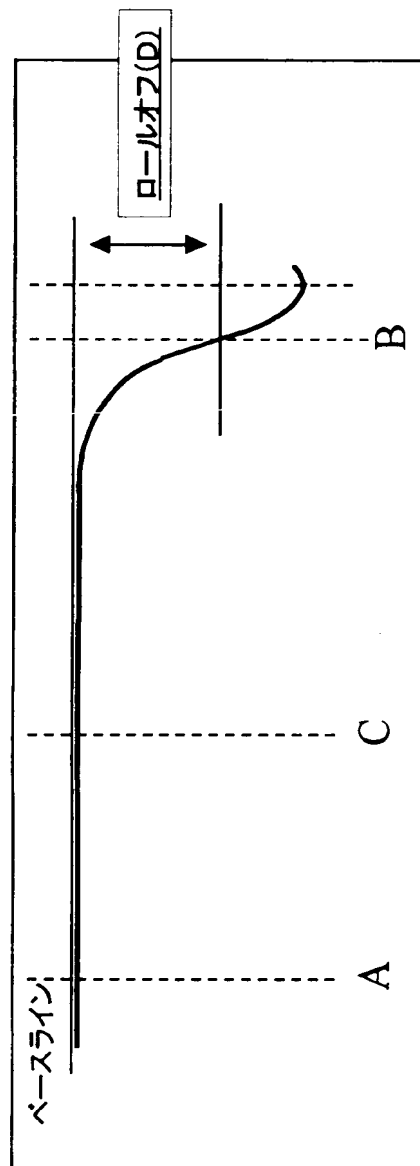
【図 1】

図 1 は、測定曲線とロールオフとの関係を示す図である。

【書類名】

図面

【図 1】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】

研磨速度が向上し、被研磨物の表面に表面欠陥を生じさせること無く、表面粗さを低減し、且つロールオフを低減し得る研磨液組成物、該研磨液組成物を用いた被研磨基板の研磨方法及び基板の製造方法を提供すること。

【解決手段】

水、研磨材、ロールオフ低減剤および中間アルミナを含有してなる研磨液であって、ロールオフ低減剤がOH基又はSH基を有する炭素数2～20のカルボン酸、炭素数1～20のモノカルボン酸、炭素数2～3のジカルボン酸及びこれらの塩からなる群より選ばれる1種以上である研磨液組成物、該研磨液組成物を用いて被研磨基板を研磨する被研磨基板の研磨方法、並びに前記研磨液組成物を用いて、被研磨基板を研磨する工程を有する基板の製造方法。

【選択図】 なし

特2000-141022

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[000000918]

1. 変更年月日 1990年 8月24日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都中央区日本橋茅場町1丁目14番10号
氏 名 花王株式会社